

## 烟台德邦科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

烟台德邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月23日召开的第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在部分募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，对部分募投项目进行延期。“年产35吨半导体电子封装材料建设项目”“新建研发中心建设项目”延期至2026年9月，“新能源及电子信息封装材料建设项目”延期至2027年2月。保荐机构东方证券承销保荐有限公司对本事项出具了明确的核查意见。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：

### 一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会签发的证监许可〔2022〕1527号文《关于同意烟台德邦科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，烟台德邦科技股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票3,556.00万股，每股发行价格46.12元，募集资金总额为164,002.72万元，扣除不含税发行费用152,543,951.12元后，本公司本次募集资金净额为1,487,483,248.88元。

募集资金总额扣除承销及保荐费(含税)人民币135,894,306.56元后的募集资金为人民币1,504,132,893.44元，已由主承销商东方证券承销保荐有限公司于2022年9月14日汇入公司在招商银行股份有限公司烟台分行开立的账号为535902385410508的人民币账户内，并经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具永证验字（2022）第210029号《验资报告》予以验证。

### 二、募集资金使用情况

截止2024年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟投入募集资金金额	累计投入金额	投资进度(%)
1	高端电子专用材料生产项目	38,733.48	37,773.21	97.52
2	年产35吨半导体电子封装材料建设项目	6,241.99	5.00	0.08
3	新建研发中心建设项目	17,690.85	1,697.47	9.60
4	新能源及电子信息封装材料建设项目	30,776.20	5,846.59	19.00
5	超募资金永久补流	50,600.00	40,600.00	80.24
合计		144,042.52	85,922.27	/

注：2023年4月14日，公司召开第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》将“年产35吨半导体电子封装材料建设项目”“新建研发中心建设项目”实施主体、实施地点、拟投入募集资金做了调整变更。

### 三、募投项目延期的具体情况及原因

#### (一) 本次延期募投项目的具体情况

公司集合目前部分募投项目的实际进展情况，在项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，拟对部分募投项目达到预定可使用状态日期进行调整，具体情况如下：

项目名称	原计划达到预定可使用状态日期	延期后项目达到预定可使用状态日期
年产35吨半导体电子封装材料建设项目	2024年9月	2026年9月
新建研发中心建设项目	2024年9月	2026年9月
新能源及电子信息封装材料建设项目	2025年2月	2027年2月

#### (二) 本次延期部分募投项目的原因

1、自募集资金到位以来，公司结合实际需要，审慎规划募集资金的使用，

根据公司战略布局及市场需求情况，集中资源优先完成“高端电子专用材料生产项目”投资建设。但由于募投项目建设周期较长，实际执行过程中受市场环境变化、行业发展变化以及订单情况等多方面因素影响，“年产35吨半导体电子封装材料建设项目”和“新建研发中心建设项目”建设进度较预期有所延迟。为确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，经充分考虑、审慎研究，公司拟将“年产35吨半导体电子封装材料建设项目”和“新建研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期延期至2026年9月。

2、2023年3月3日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司开展新项目的议案》，公司使用超募资金投资设立全资子公司新建“新能源及电子信息封装材料建设项目”。截至本公告披露日，该项目正在积极推进建设中，已完成部分主体建筑物的建设工作，但受市场及宏观环境等因素影响，项目所涉及的建设施工、采购安排、安装调试等方面存在一定程度的滞后，从而使该项目整体实施周期有所延缓，预计无法在计划时间内达到预定可使用状态，综合考虑该项目的实施进程，公司经过审慎研究论证，拟将“新能源及电子信息封装材料建设项目”达到预定可使用状态日期延长至 2027 年2 月。

#### **四、本次部分募投项目延期对公司的影响**

本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，项目的延期仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的资金用途、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，公司将继续加强对项目建设进度的监督。本次对部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划。

#### **五、履行的审议程序**

##### **（一）董事会审议程序**

公司于2024年8月23日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在部分募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，将“年产35吨半导体电子封装材料建设项目”“新建研发中心

建设项目”延期至2026年9月，“新能源及电子信息封装材料建设项目”延期至2027年2月。

## （二）监事会审议程序

公司于2024年8月23日召开了第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》。经审议，监事会认为：公司本次关于部分募集资金投资项目延期事项，仅涉及到项目进展的变化，项目的实施主体、投资总额、项目内容等各方面均未发生变化。本次延期，是公司结合项目实施进展情况做出的审慎判断，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。因此，监事会同意公司本次部分募投项目延期事项。

## （三）保荐机构意见

经核查，保荐人认为：公司本次部分募投项目延期已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规。公司本次部分募投项目延期是公司根据募投项目具体实施情况做出的审慎决定，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司正常经营活动造成重大不利影响。

特此公告。

烟台德邦科技股份有限公司董事会

2024年8月24日